



2021年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年10月29日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 笹川 謙

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2020年11月12日

配当支払開始予定日

2020年11月27日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日～2020年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第2四半期	668,160	31.4	147,429	43.9	148,228	38.9	112,012	42.3
2020年3月期第2四半期	508,442	26.4	102,454	41.6	106,692	41.1	78,722	41.8

(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 123,750百万円 (62.3%) 2020年3月期第2四半期 76,235百万円 (44.1%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年3月期第2四半期	720.29	716.05
2020年3月期第2四半期	490.18	487.48

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年3月期第2四半期	1,276,796	898,662	69.4
2020年3月期	1,278,495	829,692	64.1

(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 886,360百万円 2020年3月期 819,301百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年3月期		246.00		342.00	588.00
2021年3月期		360.00			
2021年3月期(予想)				315.00	675.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日～2021年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,300,000	15.3	281,000	18.4	281,000	14.7	210,000	13.4	1,350.57

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、「添付資料」10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2021年3月期2Q	157,210,911 株	2020年3月期	157,210,911 株
------------	---------------	----------	---------------

期末自己株式数

2021年3月期2Q	1,741,601 株	2020年3月期	1,685,556 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2021年3月期2Q	155,511,326 株	2020年3月期2Q	160,600,610 株
------------	---------------	------------	---------------

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2021年3月期2Q 617,717株、2020年3月期472,030株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2020年10月29日に機関投資家・アナリスト向けにウェブ説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	10
(セグメント情報等)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間の世界経済につきましては、前第1四半期に引き続き、新型コロナウイルスの感染蔓延による影響を受けておりますが、当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、IoT、AI、5G等の情報通信技術の用途の拡がりに伴い半導体の需要が高まっており、半導体製造装置市場は拡大基調となっております。

このような状況のもと、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高6,681億6千万円(前年同期比31.4%増)、営業利益1,474億2千9百万円(前年同期比43.9%増)、経常利益1,482億2千8百万円(前年同期比38.9%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,120億1千2百万円(前年同期比42.3%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

上述の半導体需要の増加を背景に、複数のアプリケーションにおいて装置設置の前倒しが進み、売上高は計画を上回りました。需給バランスの改善が見られるNANDフラッシュメモリに加え、DRAM、ロジック/ファウンドリ向け半導体に対する設備投資も堅調に推移し、半導体製造装置市場は四半期では過去最高水準まで回復しております。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、6,354億5千7百万円(前年同期比35.2%増)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

テレビ用大型液晶パネル向けの設備投資は継続し、モバイル用中小型有機ELパネル向けの設備投資も回復基調にあります。市場が最も大きい中国においては、新型コロナウイルスの影響により一時中断していた装置立ち上げの再開など、状況が改善し、当第2四半期においては売上高は順調に増加しております。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、326億3千6百万円(前年同期比14.9%減)となりました。

③ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、6千6百万円(前年同期比38.3%減)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
売上高	508,442	618,843	668,160	353,337
半導体製造装置	470,004	590,992	635,457	331,684
日本	73,559	85,582	106,002	56,852
北米	87,444	118,327	86,352	44,009
欧州	34,709	24,190	32,086	16,311
韓国	73,321	78,255	139,213	72,199
台湾	97,046	159,355	104,840	53,914
中国	83,925	109,741	153,081	79,123
東南アジア他	19,997	15,539	13,880	9,274
F P D製造装置	38,330	27,761	32,636	21,623
その他	108	88	66	29
営業利益	102,454	134,838	147,429	73,579
経常利益	106,692	138,287	148,228	73,138
親会社株主に帰属する 四半期純利益	78,722	106,484	112,012	55,559

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ274億1百万円減少し、9,350億8千2百万円となりました。主な内容は、有価証券に含まれる短期投資の減少335億円、未収消費税等の減少311億9千1百万円、受取手形及び売掛金の減少164億3千万円、現金及び預金の増加540億1千8百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から124億3百万円増加し、1,879億8千3百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から26億4千2百万円増加し、135億6千3百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から106億5千7百万円増加し、1,401億6千7百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から16億9千8百万円減少し、1兆2,767億9千6百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ722億7百万円減少し、3,103億7千1百万円となりました。主として、前受金の減少460億6千1百万円、未払法人税等の減少181億5千8百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ15億3千8百万円増加し、677億6千2百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ689億7千万円増加し、8,986億6千2百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益1,120億1千2百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当533億5千1百万円の実施による減少、その他有価証券評価差額金の増加104億8千3百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は69.4%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ558億9千7百万円増加し、3,038億5千6百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資550億6千8百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ205億1千8百万円増加し、3,589億2千4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ352億7千5百万円減少の1,059億2千6百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益1,477億9百万円、未収消費税等の減少312億2千3百万円、売上債権の減少166億2千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額533億8千9百万円、前受金の減少465億2千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として短期投資の減少による収入350億円、有形固定資産の取得による支出243億4千5百万円により、前年同期の505億7千7百万円の収入に対し73億9千1百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払533億5千1百万円、自己株式の取得による支出43億2千8百万円により、前年同期の1,654億3千2百万円の支出に対し579億8千9百万円の支出となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間につきましては、主力の半導体製造装置において、顧客要求の前倒しなどにより、売上高は当初予想を上回り、利益面につきましても営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益それぞれ当初予想を上回る結果となりました。

また、通期連結業績予想につきましても、最新の顧客の設備投資動向と業績動向に鑑み、2020年6月18日に公表した数値を以下のとおり修正いたします。

2021年3月期第2四半期累計期間の連結業績

	当期上半期実績	前回予想 (2020年6月18日公表)
売上高	6,681億円 (前年同期比 31.4%増)	6,200億円
半導体製造装置	6,354億円 (前年同期比 35.2%増)	5,850億円
F P D製造装置	326億円 (前年同期比 14.9%減)	350億円
営業利益	1,474億円 (前年同期比 43.9%増)	1,270億円
経常利益	1,482億円 (前年同期比 38.9%増)	1,270億円
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,120億円 (前年同期比 42.3%増)	950億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

2021年3月期通期の連結業績予想

	今回修正予想	前回予想 (2020年6月18日公表)
売上高	1兆3,000億円 (前期比 15.3%増)	1兆2,800億円
半導体製造装置	1兆2,200億円 (前期比 15.0%増)	1兆2,000億円
F P D製造装置	800億円 (前期比 21.0%増)	800億円
営業利益	2,810億円 (前期比 18.4%増)	2,750億円
経常利益	2,810億円 (前期比 14.7%増)	2,750億円
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,100億円 (前期比 13.4%増)	2,050億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。

従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	149,906	203,924
受取手形及び売掛金	150,134	133,704
有価証券	188,500	155,000
商品及び製品	267,625	254,303
仕掛品	69,514	72,071
原材料及び貯蔵品	54,924	64,418
その他	81,983	51,743
貸倒引当金	△105	△84
流動資産合計	962,484	935,082
固定資産		
有形固定資産	175,580	187,983
無形固定資産		
その他	10,921	13,563
無形固定資産合計	10,921	13,563
投資その他の資産		
その他	130,922	141,554
貸倒引当金	△1,413	△1,387
投資その他の資産合計	129,509	140,167
固定資産合計	316,011	341,714
資産合計	1,278,495	1,276,796

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	95,938	87,537
未払法人税等	52,654	34,496
前受金	135,326	89,264
賞与引当金	29,139	28,319
製品保証引当金	14,534	13,865
その他の引当金	2,492	1,592
その他	52,493	55,296
流動負債合計	382,578	310,371
固定負債		
その他の引当金	110	152
退職給付に係る負債	60,635	61,274
その他	5,478	6,335
固定負債合計	66,224	67,762
負債合計	448,802	378,134
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	702,990	761,122
自己株式	△29,310	△32,120
株主資本合計	806,652	861,973
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	20,126	30,610
繰延ヘッジ損益	△52	5
為替換算調整勘定	△4,111	△3,238
退職給付に係る調整累計額	△3,313	△2,990
その他の包括利益累計額合計	12,648	24,386
新株予約権	10,391	12,302
純資産合計	829,692	898,662
負債純資産合計	1,278,495	1,276,796

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
売上高	508,442	668,160
売上原価	303,922	403,331
売上総利益	204,520	264,829
販売費及び一般管理費		
研究開発費	56,896	66,377
その他	45,170	51,022
販売費及び一般管理費合計	102,066	117,399
営業利益	102,454	147,429
営業外収益		
受取配当金	437	737
為替差益	2,363	—
その他	1,878	1,749
営業外収益合計	4,680	2,486
営業外費用		
為替差損	—	1,177
関税追加徴収額	173	—
自己株式取得費用	114	—
その他	153	510
営業外費用合計	442	1,687
経常利益	106,692	148,228
特別利益		
固定資産売却益	2	13
特別利益合計	2	13
特別損失		
固定資産除売却損	65	532
特別損失合計	65	532
税金等調整前四半期純利益	106,629	147,709
法人税等	27,906	35,697
四半期純利益	78,722	112,012
親会社株主に帰属する四半期純利益	78,722	112,012

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
四半期純利益	78,722	112,012
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5,905	10,471
繰延ヘッジ損益	63	62
為替換算調整勘定	△9,819	896
退職給付に係る調整額	1,389	330
持分法適用会社に対する持分相当額	△26	△23
その他の包括利益合計	△2,487	11,737
四半期包括利益	76,235	123,750
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	76,235	123,750

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	106,629	147,709
減価償却費	12,835	15,255
のれん償却額	98	98
売上債権の増減額 (△は増加)	32,425	16,626
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△27,484	34
仕入債務の増減額 (△は減少)	7,073	△8,787
未収消費税等の増減額 (△は増加)	21,351	31,223
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△337	△7,704
前受金の増減額 (△は減少)	37,777	△46,526
その他	△20,975	10,208
小計	169,395	158,140
利息及び配当金の受取額	1,185	1,175
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△29,377	△53,389
営業活動によるキャッシュ・フロー	141,202	105,926
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	—	381
短期投資の増減額 (△は増加)	75,000	35,000
有形固定資産の取得による支出	△22,860	△24,345
無形固定資産の取得による支出	△1,107	△2,914
その他	△454	△729
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,577	7,391
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△108,607	△4,328
配当金の支払額	△56,651	△53,351
その他	△173	△309
財務活動によるキャッシュ・フロー	△165,432	△57,989
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,081	567
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	22,266	55,897
現金及び現金同等物の期首残高	232,634	247,959
現金及び現金同等物の四半期末残高	254,901	303,856

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置及び有機ELパネル製造用インクジェット描画装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	635,457	32,636	10,543	678,637	△10,476	668,160
セグメント利益	169,272	2,719	352	172,343	△24,633	147,709

- (注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。
2. セグメント利益の調整額△24,633百万円は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△10,702百万円、及びその他の一般管理費等であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。